



Flux de brasage "VOC free", sans nettoyage, sans halogènes pour fluxeur spray

Description:

Le flux Interflux® **PacFic 2009M** a été développé pour répondre positivement aux nouvelles exigences environnementales, il est sans composé organique volatil.

Le flux PacFic 2009M ne contient pas d'halogènes, ni résines, ni colophane. L'absence de résine et de colophane permet d'éviter les problèmes de contact électrique sur les tests "in situ".

Le flux PacFic 2009M garantit un excellent mouillage et une excellente brasabilité sur tous les types de finitions, il peut être utilisé avec les alliages SnPb et les alliages sans plomb et pour les composants et les circuits imprimés avec une brasabilité critique. Le flux convient pour le brasage sélectif, le brasage à la vague et l'étamage par immersion.

Vous pouvez changer le flux à base d'alcool au profit du flux à base d'eau virtuellement sans désavantage.



La photo n'est pas contractuelle



Propriétés physiques et chimiques	
Densité à 20°C	1,00 g/ml ± 0,01
Couleur	liquide incolore
Odeur	douce
Matière solide	3,7 % ± 0,15
Pourc. halogènes	aucun
Point éclair (T.C.C)	n.a.
Indice d'acide	25 mg KOH/g ± 2
Classif. IPC/ EN	OR/ L0

Avantages

- Absolument sans halogènes
- 100% à base d'eau
- Résiste aux températures élevées
- Pratiquement sans odeur
- Améliore les remontées dans les trous de métallisation
- Grande compatibilité avec les vernis d'épargne

Pourquoi sans COV?

- Pas de risque d'incendie causé par un flux inflammable
- Pas d'émission de composé organique volatil (COV) causé par l'évaporation du flux
- Pas d'odeur d'alcool en production causé par l'évaporation du flux
- Pas d'utilisation de diluant
- Pas besoin de vérification de la matière solide du flux
- Baisse des coûts du transport, de stockage et des assurances
- Réduction générale des consommations de flux jusqu'à 30%



Application du flux

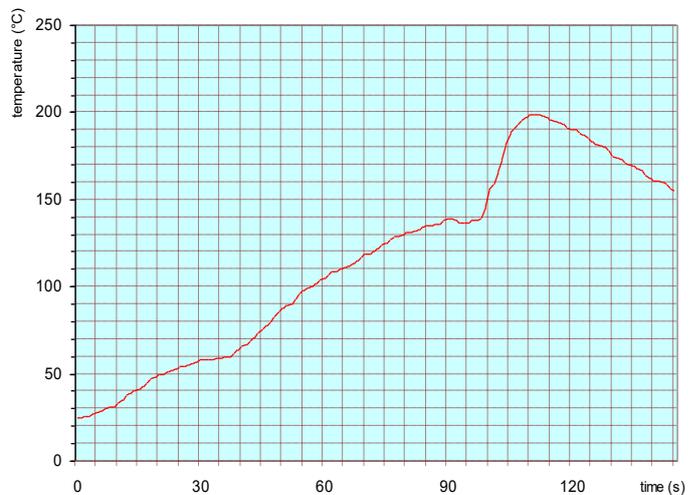
Le flux PacFic 2009M a été développé pour être appliqué par fluxeur spray. Il est recommandé d'utiliser un spray qui fluxe la carte à l'aller et au retour si possible. La pression d'air du fluxeur est préférablement assez basse pour éviter que le flux soit forcé entre le circuit et le cadre de brasage. Régler la vitesse de déplacement de la buse de façon que chaque point du circuit soit fluxé deux fois, une fois de chaque côté. Cela résultera en les bandes de fluxage qui se chevauchent à 50% de leurs largeurs. Ainsi la meilleure répartition possible du flux sous la carte est obtenue. Utiliser un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Retirer le carton de la machine avant qu'il n'atteigne le préchauffage. En complément utiliser une vitre de test ou circuit nu pour contrôler la quantité d'application de flux déposé. Retirer-les de la machine avant le préchauffage. Il ne devrait pas avoir de gouttes de flux en dessous. Les gouttes sont difficiles à évaporer et sont une indication de trop de flux. Au début, il est recommandé de réduire la quantité d'application avec environ 30% vis-à-vis la plupart des flux à base d'alcool. Baisser la quantité de flux jusqu'à obtenir les défauts typiques comme les ponts, présence de filets d'alliage ou 'webbing'. Augmenter la quantité de flux déposé jusqu'à la suppression totale des défauts.

Préchauffage

La température de préchauffage recommandée, mesurée sur le dessus du circuit, est entre 80°C-160°C. Ces valeurs sont obtenues d'expérience pratique. Toute l'eau doit être évaporée avant que le circuit soit en contact avec la vague. Le préchauffage d'air chaud peut faciliter l'évaporation d'eau mais il est recommandé d'éviter des températures d'air chaud au-dessus de 150°C si cela est possible.

Pente du préchauffage: 1-3°C/s

Toujours tenir compte des propriétés physiques de la carte, des composants et du process de brasage afin d'obtenir le meilleur résultat de brasage possible.



Exemple d'un profil de température mesuré

Contact vagues

En simple vague, le temps de contact typique est de 3-4s. En double vague, le temps de contact typique de la première vague est de 1-2s et de 2-4s pour la deuxième vague. Il est possible d'obtenir un résultat satisfaisant avec un temps de contact plus court, cependant un temps de contact plus important aura l'avantage de bien éliminer le flux lors du contact vague(s). La limite maximale du temps de contact sera déterminé par la détérioration du flux et des limitations physiques du circuit et des composants. Les indications pour la détérioration du flux sont l'apparition des ponts, 'stalactites', soude sur le vernis épargne,...



Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme EN 61190-1-1(2002) et IPC J-STD-004A

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	OR LO	J-STD-004A
Miroir de cuivre	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Quantité d'halogènes	0,00%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35
Environnement		
Test SIR	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3
Test de corrosion du flux	passe	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.15
Test de corrosion	passe	Test Bono

Sécurité

S'il vous plait, toujours consulter la fiche de sécurité.



Conditionnements

Le flux PacFic 2009M est disponible dans les conditionnements suivants:

Bouteille HDPE de 1L

Bidons HDPE de 10L et de 25L

Fût HDPE de 200L

Autre conditionnement disponible sur demande

Nom commercial du produit: PacFic 2009M VOC-Free No-Clean Soldering Flux

CLAUSE

Du fait qu'Interflux[®] Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX[®] ELECTRONICS N.V.

la dernière version de ce
document sur:

www.interflux.com/fr

